

1	2	3	4	5	6	7																																																																												
<p>一. 产品特点 (Features):</p> <p>1. 产品规格: (Product specifications):</p> <table border="1"> <tr><td>显示类型 (Display mode):</td><td>TFT/Normal BLACK</td></tr> <tr><td>驱动芯片 (Driver IC):</td><td>GC9702C</td></tr> <tr><td>人眼观察视角 (Viewing Direction):</td><td>ALL</td></tr> <tr><td>接口类型 (Interface Types):</td><td>MIPI</td></tr> <tr><td>背光类型 (Backlight Types):</td><td>12pcs, 6串2并40mA (20mA/LED), 电压为16.8V~20.4V 19.6V (TYP)</td></tr> <tr><td>模组亮度 (LCM Brightness):</td><td>450cd/m2 Min, 500cd/m2 TYP</td></tr> <tr><td>模组色坐标 (LCM Color Coordinate):</td><td>(X=0.29±0.05, Y=0.30±0.05)</td></tr> <tr><td>模组均匀度 (LCM Uniformity):</td><td>80% MIN</td></tr> <tr><td>操作温度 (Operating Temperature):</td><td>-20℃~70℃</td></tr> <tr><td>储存温度 (Storage Temperature):</td><td>-30℃~80℃</td></tr> <tr><td>平面翘曲度 (Plane Warping Degree):</td><td><=0.3MM</td></tr> <tr><td>连接器 (FPC CONNECTOR):</td><td>FH26-25S-0.3SHW</td></tr> </table>	显示类型 (Display mode):	TFT/Normal BLACK	驱动芯片 (Driver IC):	GC9702C	人眼观察视角 (Viewing Direction):	ALL	接口类型 (Interface Types):	MIPI	背光类型 (Backlight Types):	12pcs, 6串2并40mA (20mA/LED), 电压为16.8V~20.4V 19.6V (TYP)	模组亮度 (LCM Brightness):	450cd/m2 Min, 500cd/m2 TYP	模组色坐标 (LCM Color Coordinate):	(X=0.29±0.05, Y=0.30±0.05)	模组均匀度 (LCM Uniformity):	80% MIN	操作温度 (Operating Temperature):	-20℃~70℃	储存温度 (Storage Temperature):	-30℃~80℃	平面翘曲度 (Plane Warping Degree):	<=0.3MM	连接器 (FPC CONNECTOR):	FH26-25S-0.3SHW	<p>正视图</p>	<p>侧视图</p>	<p>背视图</p>	<p>背视图 (fpc弯折)</p>	<p>PIN ASSIGNMENTS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pad No.</th> <th>Pad Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>GND</td></tr> <tr><td>2</td><td>DSI_D1P</td></tr> <tr><td>3</td><td>DSI_D1N</td></tr> <tr><td>4</td><td>GND</td></tr> <tr><td>5</td><td>DSI_CP</td></tr> <tr><td>6</td><td>DSI_CN</td></tr> <tr><td>7</td><td>GND</td></tr> <tr><td>8</td><td>DSI_D0P</td></tr> <tr><td>9</td><td>DSI_D0N</td></tr> <tr><td>10</td><td>GND</td></tr> <tr><td>11</td><td>LEDK</td></tr> <tr><td>12</td><td>LEDK</td></tr> <tr><td>13</td><td>LEDA</td></tr> <tr><td>14</td><td>LEDA</td></tr> <tr><td>15</td><td>GND</td></tr> <tr><td>16</td><td>VCC_2.8V</td></tr> <tr><td>17</td><td>GND</td></tr> <tr><td>18</td><td>IDVCC_1.8V</td></tr> <tr><td>19</td><td>RESET</td></tr> <tr><td>20</td><td>FMARK</td></tr> <tr><td>21</td><td>DSI_D2P</td></tr> <tr><td>22</td><td>DSI_D2N</td></tr> <tr><td>23</td><td>LCD_ID</td></tr> <tr><td>24</td><td>DSI_D3P</td></tr> <tr><td>25</td><td>DSI_D3N</td></tr> </tbody> </table>	Pad No.	Pad Name	1	GND	2	DSI_D1P	3	DSI_D1N	4	GND	5	DSI_CP	6	DSI_CN	7	GND	8	DSI_D0P	9	DSI_D0N	10	GND	11	LEDK	12	LEDK	13	LEDA	14	LEDA	15	GND	16	VCC_2.8V	17	GND	18	IDVCC_1.8V	19	RESET	20	FMARK	21	DSI_D2P	22	DSI_D2N	23	LCD_ID	24	DSI_D3P	25	DSI_D3N	<p>模组喷码内容</p>
显示类型 (Display mode):	TFT/Normal BLACK																																																																																	
驱动芯片 (Driver IC):	GC9702C																																																																																	
人眼观察视角 (Viewing Direction):	ALL																																																																																	
接口类型 (Interface Types):	MIPI																																																																																	
背光类型 (Backlight Types):	12pcs, 6串2并40mA (20mA/LED), 电压为16.8V~20.4V 19.6V (TYP)																																																																																	
模组亮度 (LCM Brightness):	450cd/m2 Min, 500cd/m2 TYP																																																																																	
模组色坐标 (LCM Color Coordinate):	(X=0.29±0.05, Y=0.30±0.05)																																																																																	
模组均匀度 (LCM Uniformity):	80% MIN																																																																																	
操作温度 (Operating Temperature):	-20℃~70℃																																																																																	
储存温度 (Storage Temperature):	-30℃~80℃																																																																																	
平面翘曲度 (Plane Warping Degree):	<=0.3MM																																																																																	
连接器 (FPC CONNECTOR):	FH26-25S-0.3SHW																																																																																	
Pad No.	Pad Name																																																																																	
1	GND																																																																																	
2	DSI_D1P																																																																																	
3	DSI_D1N																																																																																	
4	GND																																																																																	
5	DSI_CP																																																																																	
6	DSI_CN																																																																																	
7	GND																																																																																	
8	DSI_D0P																																																																																	
9	DSI_D0N																																																																																	
10	GND																																																																																	
11	LEDK																																																																																	
12	LEDK																																																																																	
13	LEDA																																																																																	
14	LEDA																																																																																	
15	GND																																																																																	
16	VCC_2.8V																																																																																	
17	GND																																																																																	
18	IDVCC_1.8V																																																																																	
19	RESET																																																																																	
20	FMARK																																																																																	
21	DSI_D2P																																																																																	
22	DSI_D2N																																																																																	
23	LCD_ID																																																																																	
24	DSI_D3P																																																																																	
25	DSI_D3N																																																																																	
<p>2. 一般公差: ±0.2mm. (GENERAL TOLERANCE: ±0.2)</p> <p>3. 尺寸中带有“*”为重点管控尺寸. (*Dimensions of the key control and Control Dimensions.)</p> <p>4. 图纸中带有“☞”特别说明及重点确认位置. (Special Note And Key Confirmation Position)</p> <p>5. 产品所有物料符合 ROHS 规定要求. (All The Products Comply With The ROHS Requirements).</p> <p>6. 可视区开窗设计要求: 建议外壳可视区域比模块VA单边小0.3mm以上. (Visual Area Windows Design Requirements: The Proposed Shell Visual Area Than The Module VA Unilateral Small 0.3mm Above.)</p>	<p>61.98±0.5</p> <p>117.59 LCD</p> <p>113.49 POL</p> <p>110.40 LCD A.A</p> <p>56.68</p> <p>4.98 TFT</p> <p>720 (H)*RGB*1280 (V) DOTS</p> <p>0.05MM导电布</p> <p>先粘黑色胶, 再贴导电布</p> <p>8.62</p> <p>41.28</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>CONNECTION: FH26-25S-0.3SHW</p> <p>19.47±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>51.88±0.3</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>1.00MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>																																																																												
<p>二. 防静电PCB'A设计建议及要求: (The Antistatic PCB'A Design Suggestions And Requests)</p> <p>1. 在RESET信号脚上接TVS管, 连接TVS管GND要铺完整. (TVS Tube Feet, Then The RESET Signal, Connect The TVS Tube GND To Shop Complete).</p> <p>2. 信号走线, 同时两侧包GND线. (Signal Go Line, While Both Sides Of The Package GND Line).</p>	<p>61.98±0.5</p> <p>117.59 LCD</p> <p>113.49 POL</p> <p>110.40 LCD A.A</p> <p>56.68</p> <p>4.98 TFT</p> <p>720 (H)*RGB*1280 (V) DOTS</p> <p>0.05MM导电布</p> <p>先粘黑色胶, 再贴导电布</p> <p>8.62</p> <p>41.28</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>CONNECTION: FH26-25S-0.3SHW</p> <p>19.47±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>51.88±0.3</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>1.00MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>																																																																												
<p>更新喷码</p> <p>初版 (The first edition)</p> <p>变更记录 (Change History)</p>	<p>61.98±0.5</p> <p>117.59 LCD</p> <p>113.49 POL</p> <p>110.40 LCD A.A</p> <p>56.68</p> <p>4.98 TFT</p> <p>720 (H)*RGB*1280 (V) DOTS</p> <p>0.05MM导电布</p> <p>先粘黑色胶, 再贴导电布</p> <p>8.62</p> <p>41.28</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>19.50±0.5</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>	<p>CONNECTION: FH26-25S-0.3SHW</p> <p>19.47±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>51.88±0.3</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>1.00MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p> <p>79.34</p> <p>33.42</p> <p>26.00±0.3</p> <p>16.00±0.3</p> <p>3.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>*0.20±0.03</p> <p>FPC+PI补强</p> <p>1.00MAX</p> <p>0.5MM导电布</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>开压1C铜片补强T=0.1mm</p> <p>导电双面胶0.05MM</p> <p>白色对位线</p>																																																																												
<p>更新喷码</p> <p>初版 (The first edition)</p> <p>变更记录 (Change History)</p>	<p>61.98±0.5</p> <p>117.59 LCD</p> <p>113.49 POL</p> <p>110.40 LCD A.A</p> <p>56.68</p> <p>4.98 TFT</p> <p>720 (H)*RGB*1280 (V) DOTS</p> <p>0.05MM导电布</p> <p>先粘黑色胶, 再贴导电布</p> <p>8.62</p> <p>41.28</p> <p>19.50±0.3</p> <p>2.50±0.3</p> <p>7.80±0.1</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0.4MAX</p> <p>覆盖EMI电磁屏蔽膜</p> <p>19.50±0.5</p> <p>1.3MAX</p> <p>1.30MAX</p> <p>0.15mm铁框</p> <p>*1.60±0.1K (不含保护膜及FPC)</p> <p>0.05MM黄色高温胶</p> <p>元件区高度0.85MAX</p> <p>焊锡高度0</p>																																																																																	